

MES 2012 プログラム

9月12日 (水)

	A会場	B会場	C会場
10:00	【1A1】パワエレ-1 耐高温実装 1. SiCパワーデバイス実装の諸問題と世界の開発動向 ○宮代文夫（よこはま高度実装技術コンソーシアム） （依頼講演40分） 2. ナノコンポジットによるエポキシ樹脂の高耐熱化 ○竹松裕司¹、岡本健次¹、広瀬隆之¹、池田良成¹、高橋良和¹、田中祀捷²（¹富士電機、²早稲田大学大学院） 3. パワーデバイス用窒化アルミニウム基板の開発 ○金近幸博、菅原 研、藤井彩子、青木洋人、佐藤秀樹（トクヤマ） 4. 高温実装に向けたSiCパワーデバイスの金-金接合の検討 ○加藤史樹、仲川 博、郎 豊群、佐藤 弘、山口 浩（産業技術総合研究所）	【1B1】ものづくりセッション-1 1. 生産性向上を達成する次世代型硫酸銅めっき添加剤 ○広岡和洋（奥野製薬工業） 2. 金属ナノ粒子を用いた低環境負荷ナノめっき技術 ○山本陽二郎（グリーンケム） 3. 水溶性高分子のピアフィリングめっきへの応用 ○文屋 勝、志村文繁（ニッターボーメディカル） 4. LED照明用積層構造～トップMRSプロセス～ ○青木智美（奥野製薬工業） 5. 実装接合部のFIB/TEM分析 ○瀬山喜彦、高橋伸雄、栗原 丈（富士通クオリティ・ラボ）	【1C1】半導体実装 1. ファインピッチフリップチップ実装に用いるバンパ構造の検討 ○鳥山和重、岡本圭司、乃万裕一、武岡 康、折井靖光（日本アイ・ピー・エム） 2. フリップチップ実装に向けたHot-Wre法による水素ラジカル洗浄～再酸化抑制効果の検討～ ○鎌谷良介¹、野北寛太^{1,2}、太夫本 悟¹、和泉 亮¹（¹九州工業大学大学院、²福岡県産業・科学技術振興財団） 3. 表面張力を利用したSi薄ダイのセルフアライメントにおけるロバスト性評価 ○廣島 満¹、有田 潔¹、土師 宏¹、Bernhard Oberhofer²、Christhf Landesberger²、Sabine Scherbaum³、Josef Weber³、Karlheinz Bock³（¹パナソニック ファクトリーソリューションズ、²Panasonic Factory Solutions Europe GmbH、³Fraunhofer EMFT） 4. 一括積層工法におけるLSI接合技術 ○藤原康平、稲葉重信、近藤宏司（デンソー） 5. 微細Auバンパを用いたCPW接続構造体における伝送損失最小化に関する検討 ○安 陽太郎¹、菊地克弥²、加藤史樹²、根本俊介²、仲川 博²、越地耕二¹、青柳昌宏^{1,2}（¹東京理科大学大学院、²産業技術総合研究所）
11:40			
12:40	【1A2】パワエレ-2 耐熱接合材 1. パワーデバイス用高耐熱ワイヤボンディング ○余 宙¹、巽 宏平¹、濱田賢祐²、武内 彰²（¹早稲田大学大学院、²超音波工業） 2. Agワイヤの接合信頼性 ○安徳優希、手島 聡、千葉 淳、安原和彦（田中電子工業） 3. 発表中止 4. クラッド材を用いた高温Pbフリー接合材 ○山口拓人¹、池田 靖¹、秦 昌平¹、小田祐一²、黒木一真²（¹日立製作所、²日立電線）	【1B2】ものづくりセッション-2 1. 電子機器実装用低温・短時間硬化接着剤 ○徳平英士、北村和大、八木友久、伊達仁昭（富士通クオリティ・ラボ） 2. 独立回路基板上に適した無電解銅めっき処理プロセス ○本間秀和（奥野製薬工業） 3. インクジェットプロセス開発用単ノズルセット ○矢部雄一（クラスターテクノロジー） 4. 高耐食性無電解Niめっき液の開発 ○小野由加利、齋藤博之、小野寺恒太（クオルテック）	【1C2】先端材料 1. ジルコニウムアルコキシドのIn-situ重合により合成したエポキシ/ジルコニアハイブリッド材料の熱的および光学的性質 ○越智光一、荒川恵介、河野翔馬、原田美由紀（関西大学） 2. 低膨張基板対応低温ガラス ○戸田 勲、高野浩次、加東 隆、村橋浩一郎（奥野製薬工業） 3. 印刷性向上のための自己復元性生体インタフェース材料の階層的表面改質 ○安田清和（大阪大学大学院） 4. 無機フィラーによる3D-IC用層間充填材の高熱伝導化 ○河瀬康弘¹、池本 慎¹、山崎正典²、桐谷秀紀¹（¹三菱化学、²三菱化学科学技術研究センター）
14:00			

	Uホール白鷺	招待講演：Uホール白鷺
14:30	MES2011 表彰式 ・ベストペーパー賞	A会場：B3棟1階 118講義室
14:50	・研究奨励賞	B会場：B3棟1階 117講義室
14:50	招待講演 1. 電子デバイス実装の信頼性評価に関する研究—これまでの研究を振り返って— 宮崎則幸教授（京都大学） 2. 繰り返される歴史と新たな歴史—スマホなどモバイル端末の進化から— 山本義継氏（BNPパリバ証券 セミコンダクター・セクターアナリスト）	C会場：B3棟1階 119講義室 大学研究室/ものづくり展示コーナー B3棟1階 107講義室
16:50		

17:00	交流会 会場：生協食堂
19:00	

